特别声明



根据《上海证券交易所股票上市规则》及自律监管指引的要求,上市公司开展投资者关系活动,应当严格审查向外界传达的信息,遵守法律法规及交易所相关规定,体现公平、公正、公开原则,不得通过投资者说明会、分析师会议、路演、投资者调研、媒体采访等形式,向任何单位和个人提供公司尚未披露的重大信息,不得从事歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为或其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规行为。因此,敬请投资者于本次说明会中不得打探公司未公开重大信息或其他股价敏感信息,不得擅自录音录像,不得从事其他违法违规行为。

本次说明会中可能涉及的公司经营目标及相关数据系公司根据发展策略、经营计划及市场和业务发展状况做出的规划和展望,计划实施和经营目标实现以国际贸易局势稳定、电子制造服务行业健康发展、市场开拓及订单执行符合预期为前提。

本次说明会涉及的交流内容不构成对任何人的投资建议,提醒投资者关注投资风险。





环旭电子2024年第二季度 投资人线上说明会

2024年7月24日



会议嘉宾





SVP/先进移动装置及 微小化方案事业群负责人 林孟辉先生



总经理 魏镇炎先生



MCC产品管理处副处长 黄信荣先生



董事会秘书 史金鹏先生



财务总监 刘丹阳先生

业绩说明会议程





01

嘉宾简报

2024年第二季度公司经营情况 财务总监 刘丹阳先生 迎接AI浪潮的环旭电子 SVP 林孟辉先生

02

投资者线上问答



2024年第二季度公司经营情况

刘丹阳 财务总监

2024年7月24日



2024年上半年总体经营情况



营业收入人民币273.9亿元

- S S
- » 2024年第二季度营业收入与第一季度环比增长3.0%,符合预期。
- » 上半年度营业收入同比增长1.9%。

营业 收入

Revenue

净利润人民币7.8亿元

- » 第二季度营业利润率为3.2%,相较于第一季度的2.8%环比改善,优于预期。
- » 上半年度净利润率为2.9%,较去年同期持平。



获利能力

Profitability



财务指标

- » ROE、ROA、EPS 同比变化不大,EBITDA表现优于净利润。
- » 经营活动保持稳定流入,负债率应现金流的优化同比下降。

公司营业收入



单位:人民币亿元

营业收入(Q2)

138.9亿元

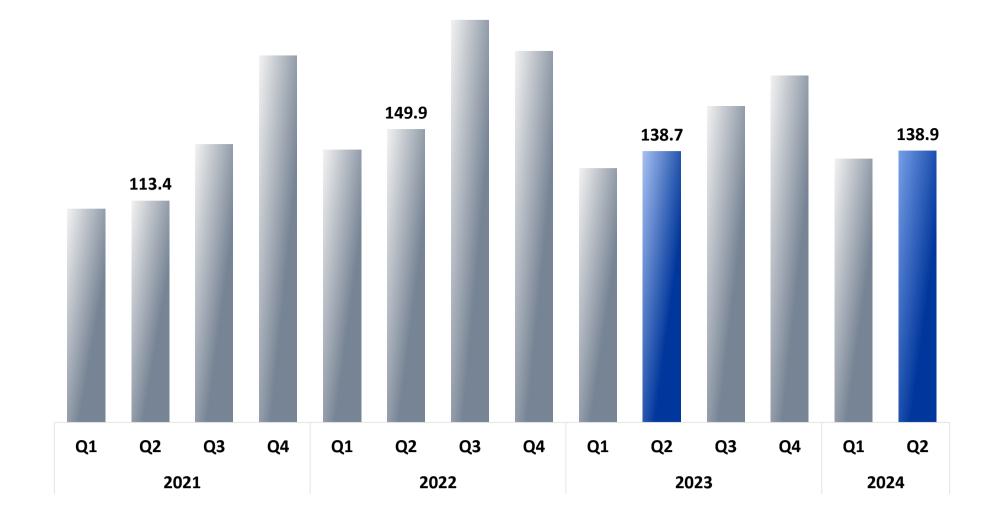
同比 🕈 0.2%

环比 🕇 3.0%

营业收入(H1)

273.9亿元

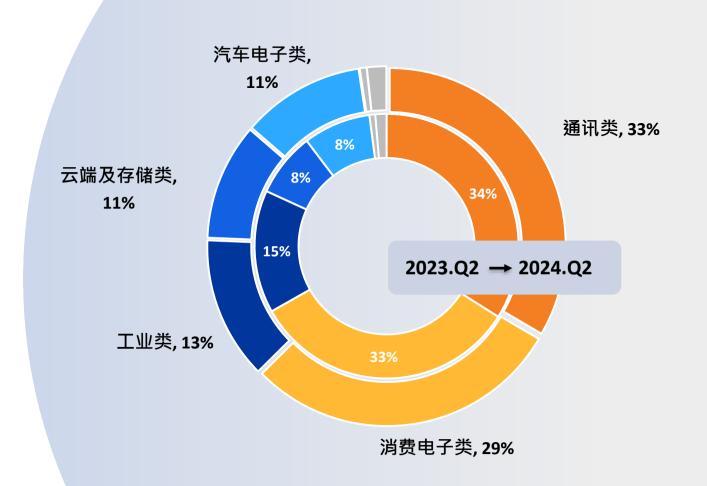
同比 🕇 1.9%



2024年第二季度营业收入



单位:人民币万元	Q2′2023	Q2'2024	YoY
通讯类	470,984.6	464,722.1	-1.3%
消费电子类	455,507.4	404,891.5	-11.1%
工业类	208,176.9	181,366.9	-12.9%
云端及存储类	108,681.7	148,493.9	36.6%
汽车电子类	114,536.9	156,614.4	36.7%
医疗电子类	9,805.7	8,556.9	-12.7%
其他	19,053.4	24,722.5	29.8%
营收合计	1,386,746.6	1,389,368.2	0.2%

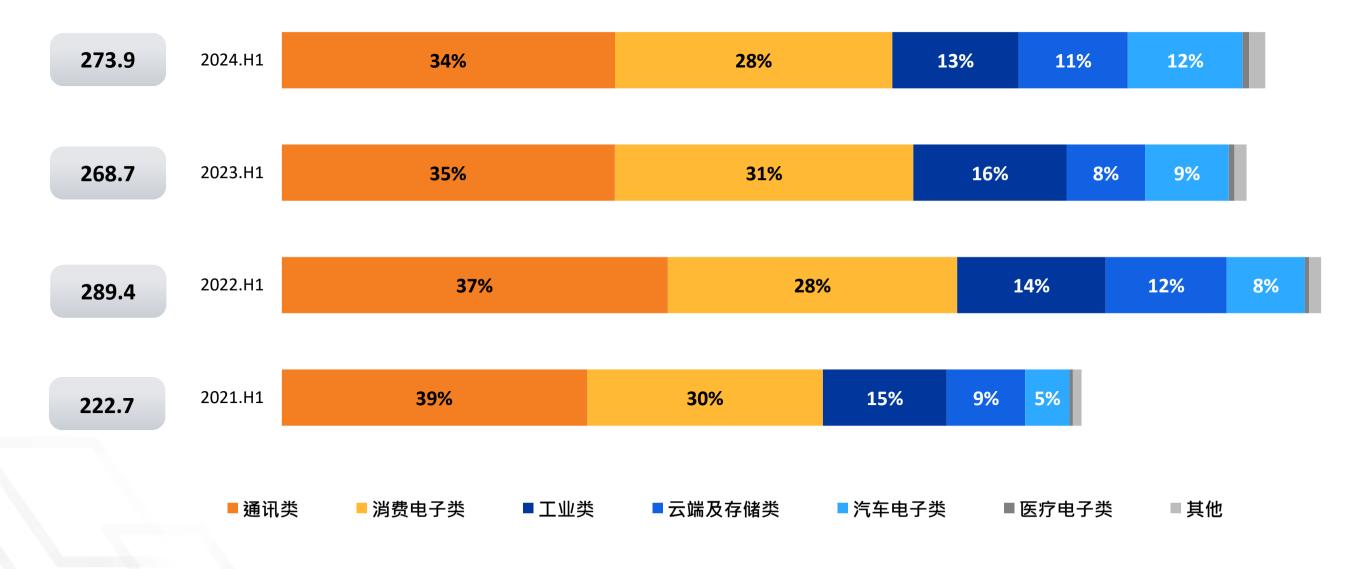




2024年上半年度公司营收结构



单位:人民币亿元



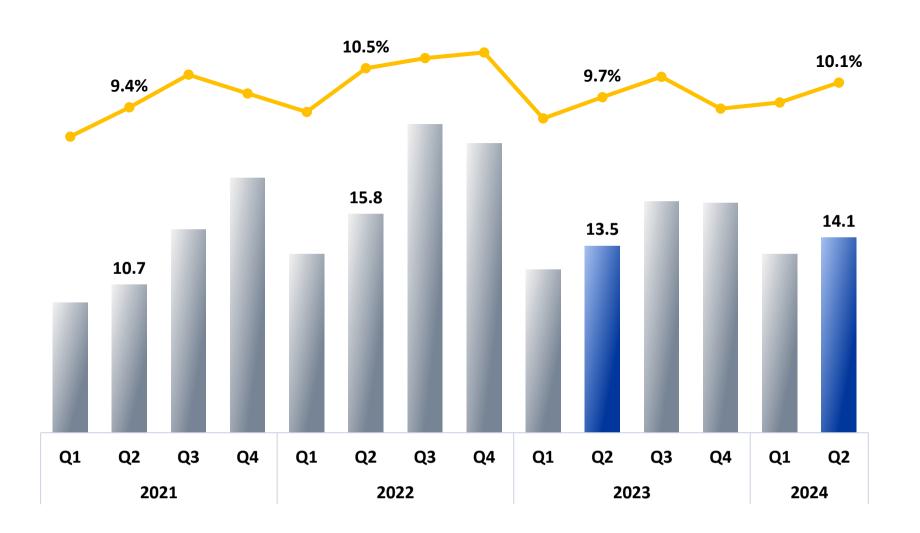
公司毛利及毛利率



单位:人民币亿元



毛利(H1) 26.9亿元 同比 ↑ 6.7% 毛利率(H1) 9.8% 同比 + 0.4%



2024年上半年度期间费用



销售 费用

◆0.5亿元

第二季度金额为人民币1.4亿、较去年同期增加人民币0.5亿、 主要因本期增加营运主体的相关费用。

管理 费用

♠0.2亿元

第二季度金额为人民币3.1亿,较去年同期增加人民币0.2亿, 主要因本期增加营运主体及营运规模扩大,以致营运成本增加。

研发 费用

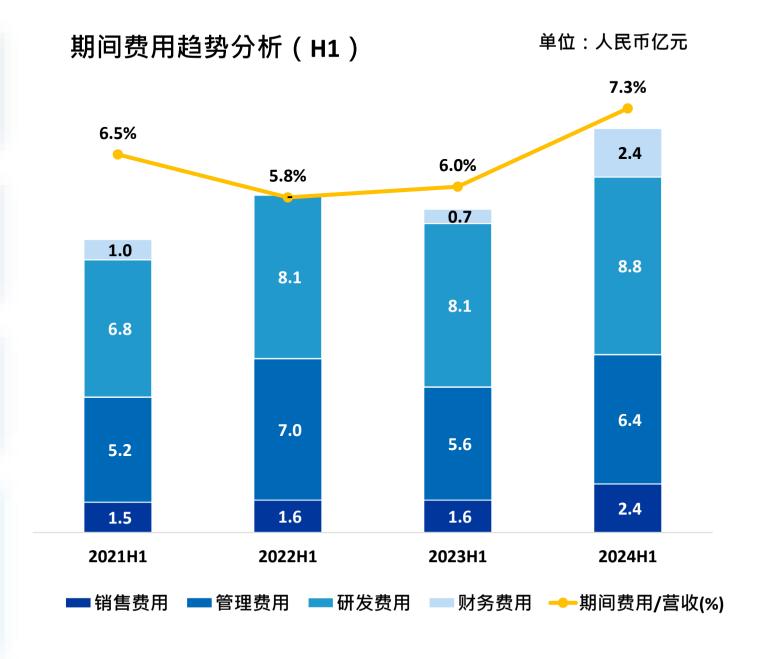
♠ 0.4亿元

第二季度金额为人民币4.5亿,较去年同期增加人民币0.4亿, 主要因本期增加营运主体的相关费用。

财务 费用

♠1.9亿元

第二季度金额为人民币1.7亿,较去年同期增加人民币1.9亿, 主要因上半年计入财务费用的外币汇兑损失增加所致,如综合 考虑汇率相关的衍生性商品所产生的已实现收益及评价收益, 汇率相关因素对公司净利润的影响有限。





公司营业利润及营业利润率



单位:人民币亿元



4.5亿元

同比 👆 19.1%

环比 16.4%

营业利润率(Q2)

3.2%

同比 - 0.8%

环比 + 0.4%

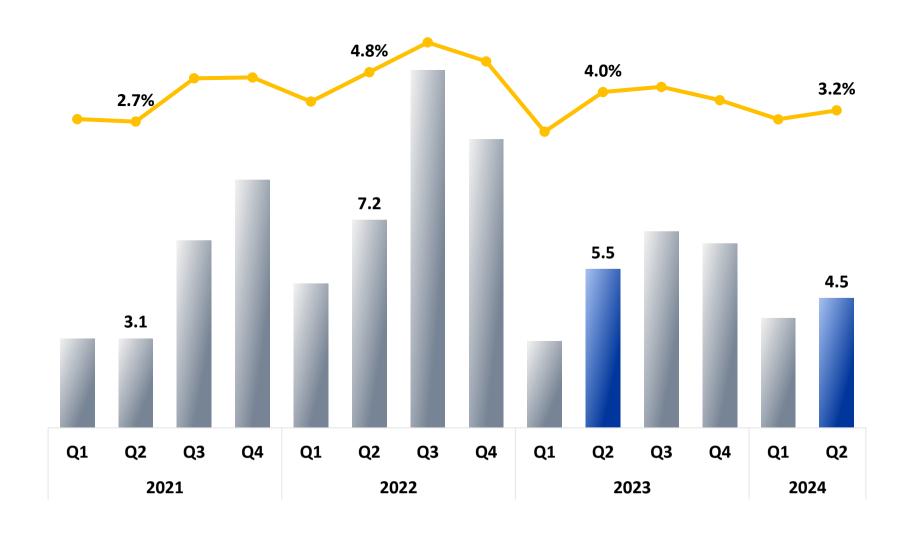
营业利润(H1)

8.3亿元

营业利润率(H1)

3.0%

同比 - 0.2%



2024年上半年度现金流



单位:人民币亿元









2024年上半年度为净流入14.0亿,主要因去年同期存货金额下降较多且由于2022年下半年为营收高峰,使得去年同期回收款项金额较大。本期应收款项回收正常及持续加强存货的控管,使得经营活动保持稳定流入。

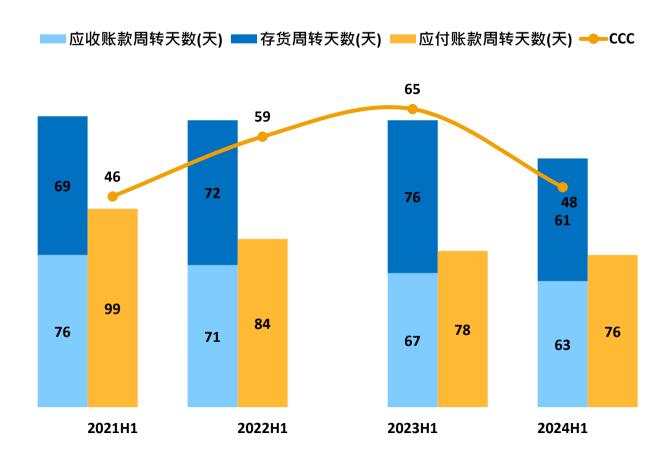
2024年上半年度为净流出,较去年同期增加 1.6亿,主要因本期支付取得赫思曼业务的 收购尾款所致。 2024年上半年度为净流出,主要因本期偿还短期借款较多及回购库存股所致。



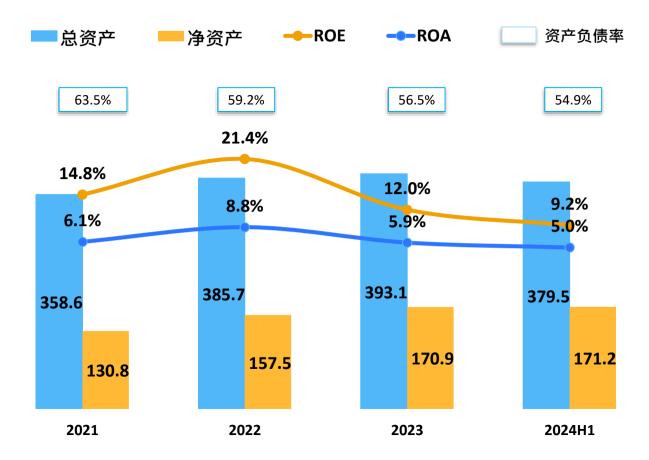
2024年上半年度营运资本周转及主要财务指标 可以 深地电影



単位・人民币亿元





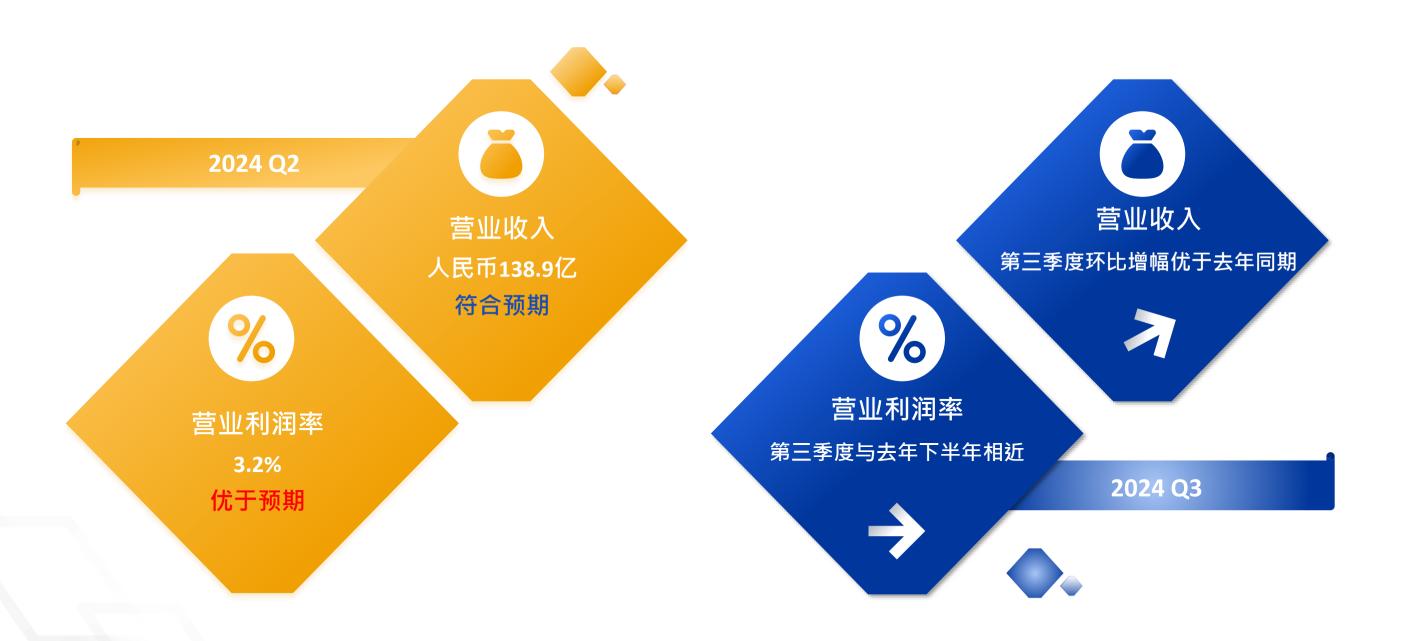


资产负债率本期为54.9%较上年度减少1.6个百分点,其中货 币资金较上年度减少人民币7.6亿。



2024年第三季度业绩预期









迎接AI浪潮的环旭电子

林孟辉

SVP/先进移动装置及微小化方案事业群负责

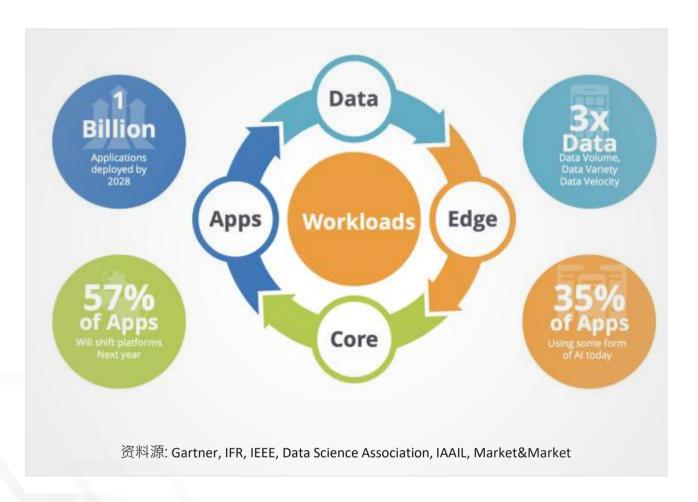
2024年7月24日

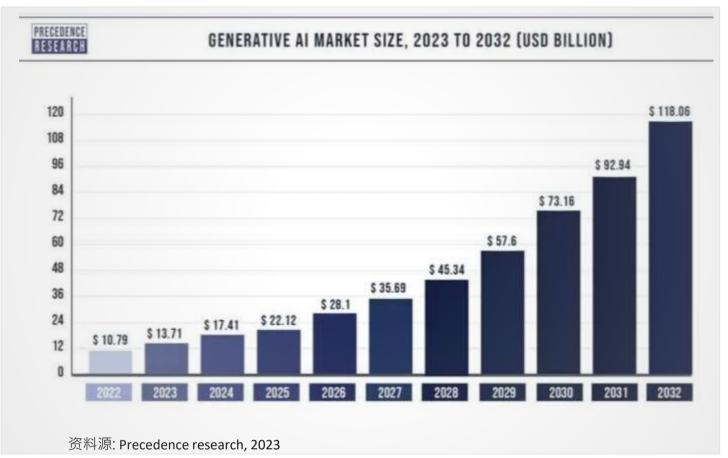


生成式AI浪潮



随着生成式AI技术的快速推展,特别是大语言模型的训练及推理的需求激增,各行业发展对算力的需求出现爆炸式增长,未来十年内,全球AI整体应用市场规模预估将出现近十倍的成长。







AI 浪潮下的新机会



随着大量AI的导入,高算力的要求带来产品升级的需求及置换周期的缩短,也为产业界迎带来质及量的向上提升。





AI 浪潮下的新机会:智能手机



以智能手机为例,随着生成式AI的大量导入,具备AI功能的手机,将从今年预估18%的占比,2028年将大幅成长至72%以上。





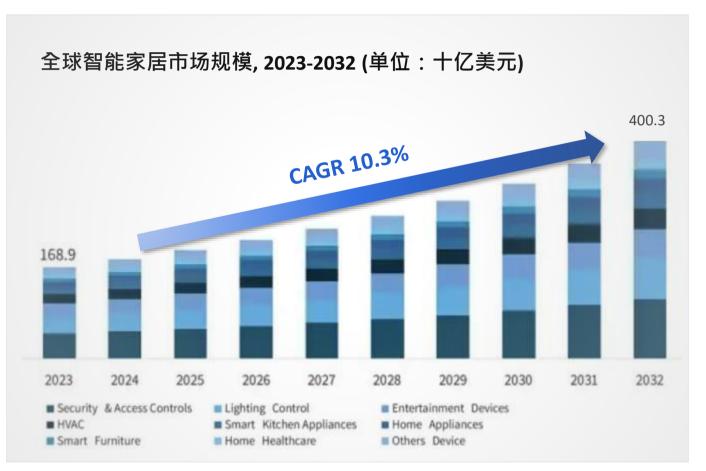
AI 浪潮下的新机会:智能穿戴、智能家居



AI的浪潮不仅带动PC及智能手机的明显换机周期,智能穿戴装置及智能家居,也因AI的导入及智能手机的连动效应,从过去几年的平缓趋势,转为明显的向上增长。



资料源: Polaris market research, Apr 2024



资料源: Global market insights, Jun 2024



AI 带动模块的成长



AI 带领PC、智能手机、智能穿戴、智能家居、自动驾驶等市场的快速转变,透过将更多功能的芯片作异质整合、 占用空间缩小及成本优化等需求之推动,全球SiP模块的市场规模未来将持续快速增长。

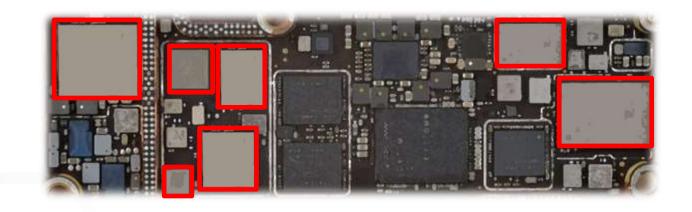


高度整合微型化的需求

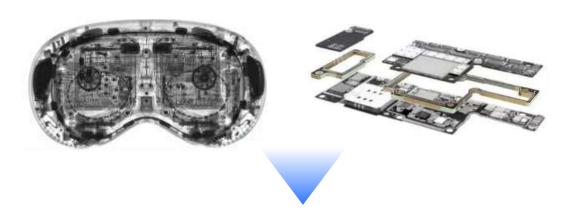


AI 高算力的特性,需更高内存及更大电池容量的支持,在产品设计上,自然转向小尺寸,低功耗及多功能整合(如电源管理、光学、传感器、射频等)的高集成模块,而更多微型化模块的导入也真正提供更大的灵活度给终端产品设计,节省下的空间用来增加电池续航力,进而让使用者真正感受AI带来的好处及个性化体验。

智能手机SiP模块数量不断增加



资料源: iFixit





AI 加速无线连网技术的演进



为满足使用者的美好体验, AI 智能移动装置必需将任务及数据,不间断的与云端服务器间作更快速的往返传输,确保边缘装置及服务器大语言模型能正确高效运行。

因此智能移动装置上的无线连网装置,也加速往最新规范演进(Wi-Fi7,5G),以支持更快更大数据量的传输。





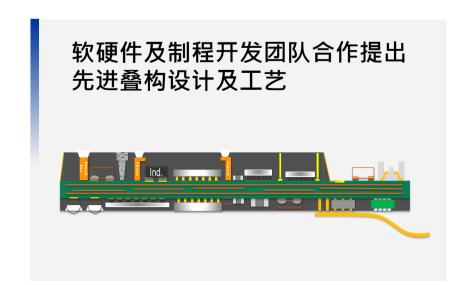
资料源: MIC, May24'

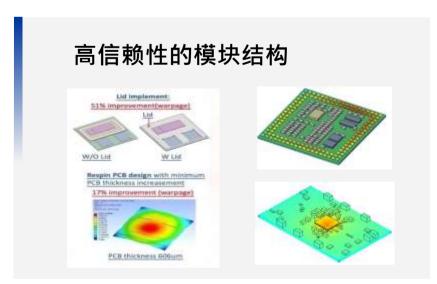


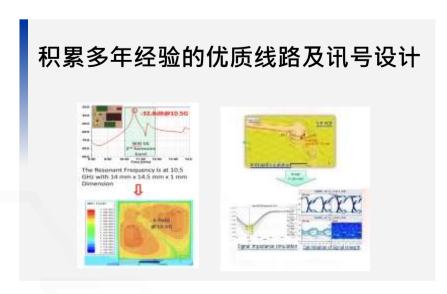
环旭电子SiP核心技术力

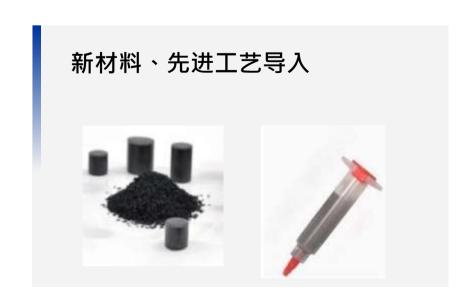


海量数据库提供软硬件整合设计、 仿真 BPF Frank











环旭电子提供的SiP模块及应用







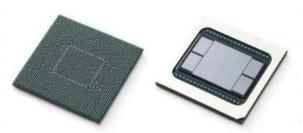


WFi 🛞 🕢 ZigBee

WFi 👔 🕢 ZigBee

持续开发先进的异质整合模块



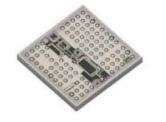


2.5D/3D IC封装、FOCoS 扇出型芯片载板整合封装





内埋式载板技术



FOSiP 扇出型系统封装



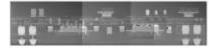
Si Photonics硅光子封装



选择性塑封



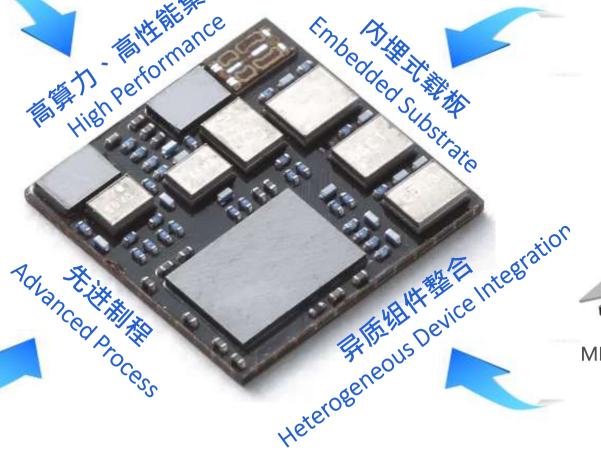
选择性屏蔽溅镀



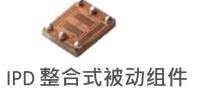
双面塑封



高密度表面贴装







MEMS 微电子机械系统



光学组件

资料源: ASE Technology Holding

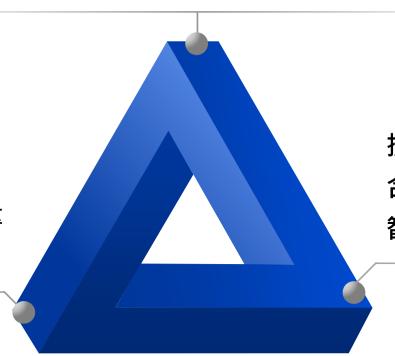


环旭电子SiP竞争优势



与高端封测及平台供应商深度合作,将环旭的SiP模块产品路线 图有效结合先进集成技术前沿及相关平台技术蓝图,提供给各 个不同市场板块客户作产品开发的参考

长期投入SiP模块业务,积累海量整合设计及问题解决数据库



提供一站式服务,包括软硬件整 合设计、微小化集成工艺开发及 智能制造服务



Q&A

特别声明

根据《上海证券交易所股票上市规则》及自律监管指引的要求,上市公司开展投资者关系活动,应当严格审查向外界传达的信息,遵守法律法规及交易所相关规定,体现公平、公正、公开原则,不得通过投资者说明会、分析师会议、路演、投资者调研、媒体采访等形式,向任何单位和个人提供公司尚未披露的重大信息,不得从事歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为或其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规行为。因此,敬请投资者于本次说明会中不得打探公司未公开重大信息或其他股价敏感信息,不得擅自录音录像,不得从事其他违法违规行为。

本次说明会中可能涉及的公司经营目标及相关数据系公司根据发展策略、经营计划及市场和业务发展状况做出的规划和展望,计划实施和经营目标实现以全球新冠疫情改善、国际贸易局势稳定、电子制造服务行业健康发展、市场开拓及订单执行符合预期为前提。

本次说明会涉及的交流内容不构成对任何人的投资建议,提醒投资者关注投资风险。

感谢您参加 投资人线上说明会

附录:公司获利分析



单位:人民币万元

项目				:	2024					20	23
次口	Q1	%	Q2	%	H1	%	Q2环比	Q2同比	H1同比	Q2	H1
营业收入	1,349,192.9	100.0%	1,389,368.2	100.0%	2,738,561.0	100.0%	3.0%	0.2%	1.9%	1,386,746.6	2,686,563.4
营业成本	1,220,389.4	90.5%	1,248,753.5	89.9%	2,469,142.9	90.2%	2.3%	-0.3%	1.4%	1,252,240.3	2,433,983.9
营业毛利	128,803.5	9.5%	140,614.6	10.1%	269,418.1	9.8%	9.2%	4.5%	6.7%	134,506.3	252,579.5
营业利润	38,344.4	2.8%	44,644.8	3.2%	82,989.2	3.0%	16.4%	-19.1%	-2.8%	55,172.2	85,411.2
所得税费用	5,947.2	0.4%	825.1	0.1%	6,772.3	0.2%	-86.1%	-87.7%	-29.0%	6,711.9	9,533.3
归属于上市公司股东的 净利润	33,468.4	2.5%	44,972.0	3.2%	78,440.4	2.9%	34.4%	-8.2%	2.2%	48,981.1	76,726.8
归属于母公司的扣除非 经常性损益的净利润	28,660.0	2.1%	31,521.9	2.3%	60,181.9	2.2%	10.0%	-33.5%	-13.3%	47,417.3	69,385.6

附录:主要财务指标分析



单位:人民币万元

项目	2023/06/30	2023/12/31	2024/06/30	2024H1 / Y2023
总资产	3,753,164.2	3,930,638.3	3,795,336.9	-3.4%
货币资金	976,030.6	1,121,869.8	1,046,360.5	-6.7%
总负债	2,168,269.4	2,221,655.4	2,083,584.1	-6.2%
有息负债	880,974.0	847,661.6	772,682.9	-8.8%
归属于母公司所有者的权益合计	1,584,847.9	1,699,040.8	1,699,228.5	0.0%
资产负债率(%)	57.8	56.5	54.9	减少1.6个百分点
项目	2023 H1	Y2023	2024H1	H1同比
项目 总资产收益率(%)	2023 H1 4.9	Y2023 5.9	2024H1 5.0	H1同比 增加0.1个百分点
总资产收益率(%)	4.9	5.9	5.0	增加0.1个百分点
总资产收益率(%) 加权平均净资产收益率(%)	4.9 9.6	5.9 12.0	5.0 9.2	增加0.1个百分点减少0.4个百分点
总资产收益率(%) 加权平均净资产收益率(%) 每股收益(元/股)	4.9 9.6 0.35	5.9 12.0 0.89	5.0 9.2 0.36	增加0.1个百分点 减少0.4个百分点 2.86%

注:1.EBITDA=净利润+所得税+利息费用(净额)+折旧摊销费用

2.总资产收益率、加权平均净资产收益率均按照年化计算

